

晶圓級甲酸迴焊爐

SRS30V Fluxless Reflow System

【功能特色】

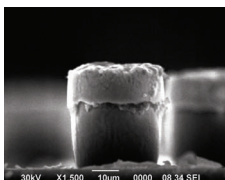
- 全製程真空腔體中運行
- 具含氧量控知模組
- 框架式晶圓移動平台
- 上下雙區溫控熱源
- 晶圓高度可調整
- 8/12吋自動切換，無需更換治具(可支援至4吋晶圓)

【產品優勢】

- 節省氮氣使用成本
- 解決錫球二次氧化
- 解決錫球內部孔洞及濺錫問題
- 減少 Particle 產生，延長維保週期
- 高良率及高產出率



Solder Bump



CU Pillar



Reflow

